

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月

目录

锦州神工半导体股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	3
锦州神工半导体股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一： 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	8
议案二： 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	9
议案三： 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	18
议案四： 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	21
议案五： 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	25
议案六： 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	27
议案七： 《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》	28
议案八： 《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》	29

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先

发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于

召开 2021 年年股东大会的通知》（公告编号 2022-026）。

特别提示：因疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具 48 小时内核酸阴性证明，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，参会人员还需配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022 年 5 月 13 日（周五）14:00

(二) 会议地点：锦州市太和区中信路 46 号甲公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 审议会议议案：

1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

7、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

8、《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问；

- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果；
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 会议结束。

议案一：

《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东和股东代表：

公司已于 2021 年 4 月 19 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案二：

《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

各位股东和股东代表：

一、2021 年公司经营情况讨论与分析

2021 年，尽管全球经济增长仍然受到诸多不利因素制约，但是新动能和新趋势已经初露峥嵘：全球范围内的疫情肆虐使得人们尽可能选择居家办公，采用视频和音频云会议，大大地增加对数据计算和存储芯片的需求。另一方面，5G 移动终端渗透率持续提升、汽车电动化显著加速、物联网设备泛在智联、“碳中和”目标深入人心。这些新动能和新趋势，都依赖于半导体器件特别是集成电路产品增强性能、削减能耗并降低成本。全球范围的“缺芯潮”也推动“芯片制造本土化”浪潮。因此，2021 年全球半导体产业取得了远超经济整体增速的长足发展：根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）2022 年 3 月最新发布的数据，2021 年全球半导体市场销售额达 5,560 亿美元，同比增长 26.2%。公司扎根于分工严密的国际半导体供应链中，所处硅材料细分行业在整个半导体产业链上游，经营业绩与上述数据所呈现的半导体行业景气度高度相关。

从产业链角度分析，公司的大直径硅材料产品，直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商，后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给三星、英特尔和台积电等国际知名集成电路制造厂商。根据上述国际主流刻蚀机设备厂商和集成电路制造厂商的公开披露财务数据，下游市场景气度持续提升，需求旺盛。

受下游需求带动，报告期内，公司刻蚀机用大直径硅材料订单大幅增加。在产品成本、良品率、参数一致性等关键指标上，公司持续提升其全球竞争优势。并在此基础上，及时地增加了大直径硅材料的产能规模，提高了对客户的稳定供货能力，面对市场机遇，公司还根据市场需求优化产品结构，利润率较高的 16 英寸及以上大直径硅材料销售收入进一步提升，对净利润增长有较大贡献。2021

年全年，公司实现营业收入 47,389 万元，比去年同期增长 146.69%；归属于上市公司股东的净利润 21,844 万元，比去年同期增长 117.84%。

2022 年以来，手机等消费电子产品动能有所衰减，物联网和电动汽车所需芯片以及中高端模拟芯片的结构性供需矛盾依旧突出，射频芯片、电源管理芯片、微控制器需求依然旺盛。下游客户较高的开工率水平，对公司的稳定供货能力和产品的品质标准提出更高要求；更先进的制程工艺所需的与之匹配的高标准硅材料及硅零部件，对公司产品技术研发能力提出更大的挑战；全球半导体产业链的“本土化制造”浪潮，推动下游客户为确保供应稳定和成本可控，更积极地与公司在内的本土供应商合作。

面对新的机遇和挑战，公司具体工作开展情况如下：

（一）国内外市场拓展

大直径硅材料方面，公司根据下游市场需求不断优化产品结构，提升了利润率较高的 16 英寸及以上大直径产品占比，并开展 22 英寸半导体硅零部件所需多晶质材料的工艺攻关；硅零部件产品方面，国内 12 英寸集成电路制造产能的持续扩张，更多机台工艺进入成熟状态，硅零部件需求将随之增长，公司抓住机会推进了客户端的评估工作；半导体大尺寸硅片方面，公司的 8 英寸测试硅片已经通过了某些国内客户的评估认证，同时，8 英寸轻掺低缺陷高阻硅片，正在客户端评估中，进展顺利，另外，公司完成了与国内主流客户在技术难度较高的 8 英寸硅片上的规格对接工作，并启动了后续的评估送样工作。

（二）扩产计划

根据公司下游硅零部件厂商和终端用户的需求来看，2021 年大直径硅材料市场保持了高景气度。公司根据直接客户订单数量并结合行业的需求增速，及时地进行了产能的扩充；一方面保证产品稳定的交付能力，另一方面也为公司未来业绩增长奠定基础；硅零部件产品，根据送样评估进度，客户订单数量，公司适度的增加了装机数量，稳步地提高了产能规模；同时，公司规划了新的生产场所，按最大设计的装机能力来看，产能将处于全国领先地位；大尺寸硅片产品，公司 8 英寸轻掺低缺陷硅片的设备产能为月产 5 万片，报告期内，完成了前期的基本工艺稳定的目标，并配合客户端的评估进度，进行了小批量的生产；另外，订购了月产 10 万片的硅片加工设备，为客户评估之后的大批订单提前做好准备。

（三）研发情况

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，公司通过构建科学合理的研发体系，使公司研发方向能够始终紧随行业前沿步伐，又能紧密贴合客户实际需求。目前公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中，并在相关细分领域形成了一定的优势。

为应对晶体“大型化”的需求，报告期内，公司引入新型的长晶设备，同时优化热系统，对生产过程进行数字化升级，既提高了管理精细度，还优化了工艺方案，实现效能提升；此外，公司还不断优化包括晶体尺寸、缺陷密度、元素含量、元素分布均匀性在内的一系列参数指标，为客户提供稳定的优质大直径硅材料。报告期内，公司研发团队还开展了 22 英寸以上半导体硅零部件所需多晶质材料的工艺攻关，取得了更多的热场优化试验数据，良品率继续提高，持续优化晶体各项理化指标所对应的工艺。

公司在硅零部件的高精度加工方面也取得突破。为配合客户做下一代先进制程设备的零部件的研发工作，实现新机台的配套，公司开发了适用于 12 英寸等离子刻蚀机不同工艺的硅电极产品；集成电路制造厂家不断提高等离子体刻蚀工艺的精度标准，硅零部件的大尺寸化和加工精度也随之提高，公司的晶体材料质量和加工水平都能满足客户的需求。报告期内，公司扩大了硅零部件产能，进一步提高了从原材料到成品的技术生产衔接，加强了研发团队针对各种加工方法的反馈速度和反馈强度。

（四）募投项目进展

公司通过对 8 英寸晶体生长和硅片加工工艺的研发，稳定工艺窗口，逐步掌握了对晶体内部缺陷的控制方法，可以持续稳定地满足客户对 COP 等晶体缺陷指标的苛刻要求。报告期内进行了小批量的生产，产量为 8,000 片/月，产品大多数的技术指标和良率已经达到或基本接近业内主流大厂的水准。硅片各项指标数据稳定，符合规格要求，合格率及良率逐步提升。

二、董事会及各专门委员会日常工作情况

2021 年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，进一步完

善法人治理结构，规范运作，认真落实股东大会各项决议，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。

（一）股东大会会议召开情况

2021 年度，公司召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	审议通过：1、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；6、关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案；7、关于 2021 年度董事薪酬方案的议案；8、关于 2021 年度监事薪酬方案的议案；9、关于 2020 年度监事会工作报告的议案；10、关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 19 日	审议通过：1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。

（二）董事会会议召开情况

2021 年度，公司召开 7 次董事会，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十六次会议	2021 年 3 月 8 日	审议通过 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021 年 4 月 16 日	审议通过 1、《关于公司 2020 年年度报告及其

		摘要的议案》2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》9、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》10、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》11、审议通过《关于会计政策变更的议案》12、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》13、审议通过《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》15、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 21 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第一届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 2 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大

		会的议案》
第二届董事会第一次会议	2021 年 8 月 30 日	1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第三次会议	2021 年 12 月 27 日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

（三）董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

三、公司发展战略

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为在全球半导体级硅材料及其制品领域内，有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀硅材料供应商。公司将继续着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；建立起自己的技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。

（一）大直径硅材料

在研发方面，公司将紧跟行业前沿客户的研发步伐，继续优化最大至 22 英寸的大直径单晶硅材料的工艺手段，提升成品率和产量。同时不断地深化多晶质硅材料制造技术，争取年内形成稳定多晶硅材质硅零部件量产；在市场开拓方面，公司将继续深耕重点客户，在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时，注

重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触，逐步发展国内的销售网络，抓住国内半导体行业发展的机遇，扩大国内市场销售的份额；在产能方面，公司发挥其技术优势，通过工艺改进和设备升级来增加产量，同时，将根据下游客户的订单及市场预期，适时地扩大生产规模，一方面保证稳定的产品交付能力，一方面也为公司未来业绩增长奠定基础。

（二）硅零部件

在研发方面，公司紧随全球硅零部件产品的研发趋势，将继续与国内等离子刻蚀机制造厂商共同研发硅零部件产品，并深度服务国内终端集成电路制造厂商，持续推进定制研发和送样认证，继续扩展硅零部件图纸库和技术规格数据库；在市场开拓方面，随着国内 12 英寸集成电路制造产能的持续扩张，更多机台工艺进入成熟状态，硅零部件需求将随之增长，公司将抓住机会继续推进客户端评估，公司将“积少成多”，推动更多硅零部件规格进入评估认证；在产能方面，硅零部件产品规划的设计产能居全国领先地位，公司将加快在锦州建设硅零部件加工场所进度，提高从原材料到成品的技术生产衔接，加强研发团队针对各种加工方法的反馈速度和反馈强度，锦州硅零部件工厂建成后，公司南北两处厂区的布局可以更好地服务国内市场。

（三）半导体大尺寸硅片

在研发方面，公司将与国内重掺外延硅片厂商形成差异化竞争，继续发挥公司在晶体生长方面的独特优势，深化轻掺低缺陷硅片方面的技术工艺研发，对标国内主流集成电路制造厂商大量使用的硅片，快速提高产能，以满足该规格硅片的国内大批量需求。此外，公司还将根据集成电路制造厂商提供的具体技术要求，持续优化超平坦硅片、超高电阻硅片、氩气退火片等特殊工艺轻掺硅片，发挥公司技术优势，占据一系列利润率较高的细分硅片市场。在市场开拓方面，公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作，力争在年内得到主流集成电路制造厂商的正片评估通过结果并取得小批量订单；在产能方面，公司大力推动产品评估认证工作，并根据认证及之后的订单情况，将产量逐步提升至当前设备最大产能，即 50,000 片/月，并力争达到与业内先进厂商同等的良品率。公司已追加订购了每月 10 万片的硅片加工设备，随着该批设备陆续进场，及时进行安装和调试工作，为之后批量生产做准备。公司坚持稳扎稳打，不骄不躁的

理念，生产规模的扩展既要满足工艺稳定、较高良率的要求，又满足客户送样认证及批量订货之所需。另外，公司将继续优化 12 英寸硅片级晶体的技术参数。争取早日实现 12 英寸硅片的试生产。

未来，公司将继续依托自身的技术优势及丰富的半导体市场经验，增加技术研发投入，提高生产管理效率，并紧密围绕国家战略，成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者。

四、经营计划

近年来，国内半导体材料市场快速发展。根据 SEMI 数据，2021 年中国大陆半导体材料市场规模达 119.29 亿美元，同比增长 21.9%，年度增长率为全球第一。虽然中国半导体行业整体销售规模持续扩张，但半导体材料及设备依然严重依赖进口，无法满足国内快速增长的市场需求。公司是国际领先的大直径硅材料产品制造商，以此为基础，逐步扩展了硅零部件及 8 英寸单晶抛光片两大主营产品。2022 年，公司拟定如下经营目标：

（一）大直径硅材料领域

公司将积极扩大大直径硅材料产品的产能规模，结合客户的订单预期以及行业未来几年的发展需求，着手进行生产厂房的基础建设工作；并通过工艺改进和设备升级等多方面手段来增加既有生产设备的单炉次产量，有效地控制成本；发挥公司特有的晶体生长技术优势，确保产品品质上的稳定性，一致性，保持国际上的领先地位；

多晶质产品方面，在稳定工艺窗口的基础上，根据客户评估进度以及订量数量，稳步提高月产量，形成一定规模的销售收入；同时，加深与客户端的研发合作，特别是针对下一代等离子刻蚀机对大直径材料提出的严苛指标，开展更多研发工作，做好技术储备；

（二）硅零部件领域

在国内 12 英寸集成电路制造厂商需求的快速增长带动下，公司的硅零部件产品将获得更多国内客户的评估认证机会，并形成稳定的批量订单。为保证客户订单的及时交付，公司会扩大生产规模，做好设备采购、安装调试等前期准备工作，确保年内可以实现较快速度的产能爬升；

公司将加快在锦州建设硅零部件工厂的进度，并集中力量，针对国内 12 英寸集成电路制造厂商的特殊硅零部件需求，展开更多品种硅零部件的研发工作；同时，年内实现批量化、规模化生产。锦州硅零部件工厂建成后，公司南北两处厂区的布局可以更好地服务全国市场。

（三）半导体大尺寸硅片领域

公司将确保更高产量条件下的高良率水平，现有生产设备逐步达到最大产能；随着已订购设备的陆续进场，安装调试等工作的进行，公司大尺寸硅片产能将继续稳健扩充。公司将根据下游客户的技术要求，深化低缺陷路线下的高技术含量及高毛利优势产品的研发及批量生产工作，如轻掺高阻硅片、超平坦硅片、氟气退火片等，争取年内获得国内主流集成电路制造厂认证通过并形成小批量订单；公司将继续探索并积累 12 英寸半导体级低缺陷晶体的生长工艺。

（四）人才梯队建设

公司计划未来将股权激励作为常态化的激励机制，继续引进具备丰富生产、管理经验的复合型专家和技术人员，扩充到现有的中、高级管理人员团队，加强建设高水平人才梯队，持续提升人才竞争优势。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案三：**《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

各位股东和股东代表：

2021 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会七次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司召开 7 次监事会，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第十四次会议	2021 年 3 月 8 日	审议通过 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第十五次会议	2021 年 4 月 16 日	审议通过 1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》9、审议通过《关于会计政策变更的议案》10、审议通过《关于变更

		公司营业范围并修订<公司章程>的议案》11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第十六次会议	2021 年 4 月 21 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第一届监事会第十七次会议	2021 年 8 月 2 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第二届监事会第一次会议	2021 年 8 月 30 日	1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
第二届监事会第二次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第二届监事会第三次会议	2021 年 12 月 27 日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

二、公司相关事项的规范运作

2021 年度，公司监事会全体监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司治理情况、财务情况等相关重要事项进行了监督和核查，具体情况如下：

1、公司治理情况

2021 年度，公司股东大会、董事会严格依照《公司章程》和相关法律法规行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。2021 年度，公司董事、高级管理人员充分依照法律及公司制度的规定履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，确保了公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。

2、公司财务情况

2021 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公

司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为公司财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2021 年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2021 年度，公司未发生需要经董事会审议的关联交易事项。公司不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司对外担保及关联方资金占用情况

2021 年度，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

5、公司募集资金使用与管理情况

2021 年度，公司监事会对募集资金存放与使用情况进行了核查。监事会认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2022 年年度工作计划

2022 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，结合公司业务发展实际，有效防范和控制风险，进一步促进公司的规范运作。同时不断加强自身学习，忠实履行职责，持续依法行使监事会各项职权，监督公司依法运作情况、审核定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查、依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关会议，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合规性，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案四：

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

各位股东和股东代表：

为更全面、详细地展现公司 2021 年的财务状况和经营成果，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

2021年度，锦州神工半导体股份有限公司年财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2022]第1-10642号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下：

一、2021 年总体经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 473,890,118.61 元，其中大直径硅材料 15 寸以下产品实现收入 148,605,581.83 元，比上年同期增加 134.43%；大直径硅材料 15-16 寸产品实现收入 185,852,084.42 元，比上年同期增加 145.53%；大直径硅材料 16 寸以上产品实现收入 119,465,643.89 元，比上年同期增加 175.72%。实现营业利润 253,205,260.40 元，较上年同期增加 125.62%；归属于上市公司股东的净利润 218,442,472.45 元，较上年同期增加 117.84%；经营活动产生的现金流量净额为 189,125,285.87 元，较上年同期增加 30.50%。

二、报告期内公司经营业绩分析

1、资产、负债状况

公司2021年末总资产1,489,085,744.17元，同比增长10.42%；负债总额74,909,170.14元，同比减少45.21%；归属于上市公司股东的所有者权益总额1,414,176,574.03元，同比增加16.70%；资产负债率为5.03%。

其中，（1）货币资金较上期末减少18.18%；（2）交易性金融资产较上期末减少2.25%；（3）应收账款较上期末增加91.75%，主要系本期收入增长所致；（4）预付款项较上期末增加351.42%，主要系购买原材料增加所致；（5）固定资产较上期末增加13.68%；（6）在建工程较上期末减少4.93%；（7）其他非流动资产

较上期末增加566.25%，主要系购买设备、在建工程等长期资产增加所致；（8）递延所得税资产较上期末减少11.82%；（9）应付账款较上期末减少75.09%，主要系应付材料款比例减少所致；（10）应交税费较上期末减少26.96%；（11）递延收益较上期末减少25.60%。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：元 币种：人民币

费用项目	2021年度	2020年度	同比增减幅度（%）	2019年度
销售费用	4,510,689.65	2,954,826.91	52.65	2,924,576.27
管理费用	35,266,183.82	22,898,281.12	54.01	26,545,758.09
财务费用	-10,738,051.34	-12,105,207.68	不适用	-1,379,446.11
研发费用	34,971,136.38	17,901,051.11	95.36	9,893,957.97

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加52.65%，主要系销售人员数量的增加、薪酬水平的提升所致；同时采取积极的市场拓展策略，相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加54.01%，主要系公司经营规模扩大，为提升治理水平和管理能力，增加了人力资源投入和合理调增薪酬所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加95.36%，主要系公司持续增强研发投入特别是半导体级8英寸轻掺低缺陷抛光硅片项目，扩张研发团队规模，加强研发活动，投入研发费用较上年同期有较大增幅。

3、现金流量状况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	570,913,518.86	230,241,699.15	147.96
经营活动现金流出小计	381,788,232.99	85,318,658.66	347.49
经营活动产生的现金流量净额	189,125,285.87	144,923,040.49	30.50

投资活动现金流入小计	439,055,303.57	19,223,232.77	2183.98
投资活动现金流出小计	698,802,231.97	497,504,311.64	40.46
投资活动产生的现金流量净额	-259,746,928.40	-478,281,078.87	不适用
筹资活动现金流入小计	1,825,819.84	792,750,566.07	-99.77
筹资活动现金流出小计	17,819,843.80	46,702,074.89	-61.84
筹资活动产生的现金流量净额	-15,994,023.96	746,048,491.18	不适用
现金及现金等价物净增加额	-90,336,965.90	408,836,439.71	不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司闲置资金投资回收期间不同所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期进行股利分配，而去年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

4、主要数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
营业收入	473,890,118.61	192,097,477.36	146.69	188,586,021.47
归属于上市公司股东的净利润	218,442,472.45	100,276,468.28	117.84	76,949,820.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,126,167.39	89,644,425.04	138.86	76,184,570.27
经营活动产生的现金流量净额	189,125,285.87	144,923,040.49	30.50	112,865,178.26
基本每股收益(元/股)	1.37	0.65	110.77	0.64
稀释每股收益(元/股)	1.37	0.65	110.77	0.64
净资产收益率(%)	16.64	9.62	72.97	22.16
	2021年末	2020年末	本年末比上年 末增减(%)	2019年末
总资产	1,489,085,744.17	1,348,567,761.67	10.42	384,648,253.60
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)	1,414,176,574.03	1,211,846,637.14	16.70	360,704,903.17

1、营业收入同比增长 146.69%，主要系报告期内全球集成电路产业蓬勃发展，景气度持续提升，公司大直径硅材料订单需求大幅增加，营业收入实现较大幅度增长。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 117.84%，主要为客户对大直径硅材料的订单大幅增加，公司原材料价格上涨，成本增加等多重因素所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 138.86%，主要系在净利润保持增长的前提下，本期非经常性损益项目较上期减少 59.40% 所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.50%，主要系公司市场预期好、营业收入增加，业务规模扩大，增加存货采购综合影响所致。

5、基本每股收益、稀释每股收益同比增长 110.77%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 131.03%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案五：

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

各位股东和股东代表：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合宏观环境、行业趋势、市场状况，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为锦州神工半导体股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2022 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划等，按照合并报表口径进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2022 年度主要财务预算指标

2022 年度公司预算目标：以 2021 年营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率大于 18%；以 2021 年净利润为基数，2022 年的净利润增长率大于 10%。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场

状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案六：

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

各位股东和股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 218,442,472.45 元，公司期末可供分配利润为人民币 339,860,773.04 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.03%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司已于 2021 年 4 月 19 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024），具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案七：

《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2022 年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人 12 万元/年（税前）。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

议案八：

《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

公司制定了 2022 年度监事薪酬方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不额外向监事支付监事职位薪酬。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日